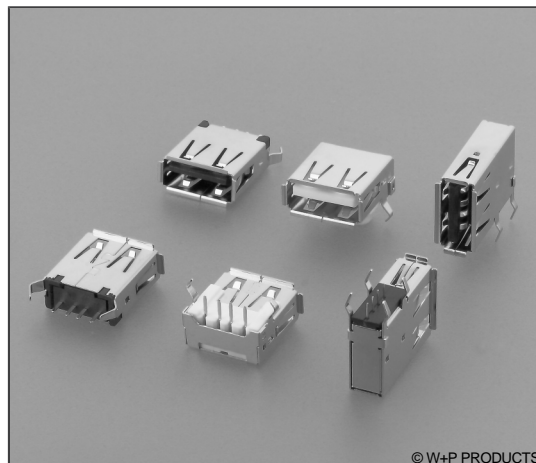
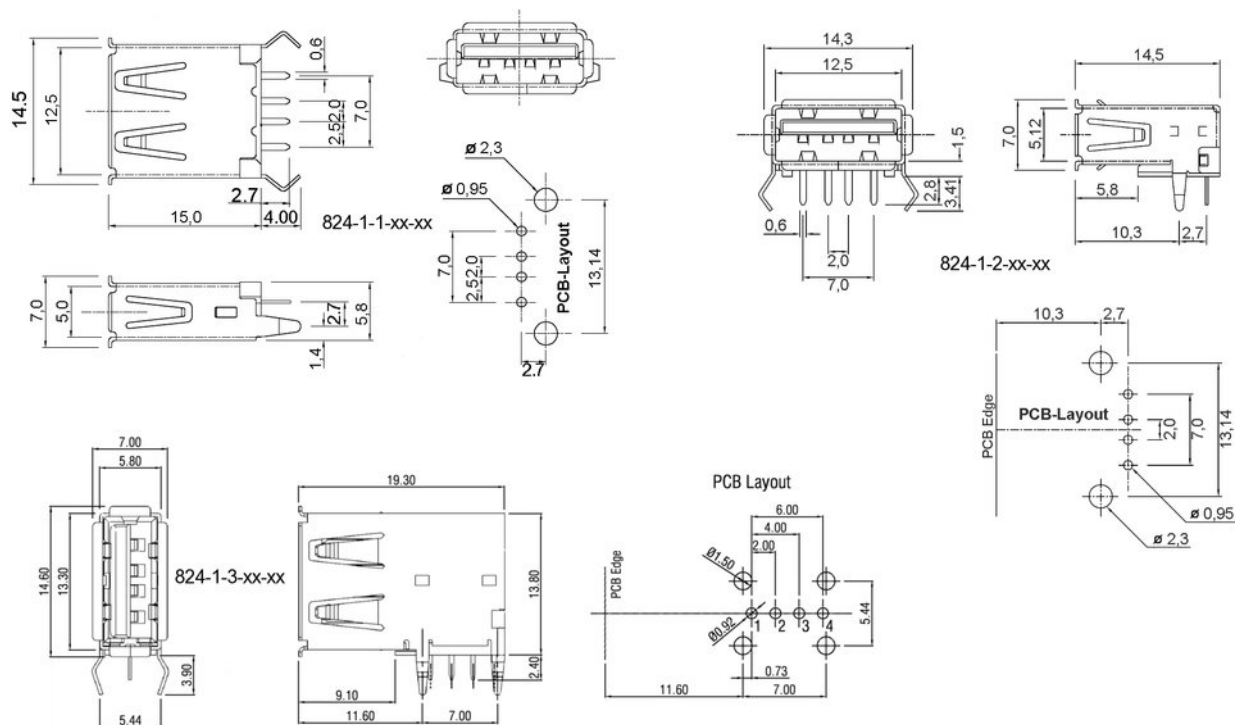


Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Messing, verzinkt
Shell	Tin plated brass
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel (siehe Optionen unten)
Contact Surface	Gold over nickel (see options below)
Oberfläche Lötanschluss	Zinn über Nickel
Plating Solder Side	Tin plated over nickel
Durchgangswiderstand	< 30 mΩ
Contact Resistance	< 30 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	500 V AC
Nennspannung	30 V RMS
Voltage Rating	30 V RMS
Nennstrom	1,5 A bei 25°C
Current Rating	1,5 A at 25°C
Temperaturbereich	-55 °C ... +85 °C
Temperature Range	-55 °C ... +85 °C
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	Wave soldering



© W+P PRODUCTS



Series	Type	Model*	Colour*	Plating*
824	1	1	30	80
	1 Type A (female)	1 Top entry Top entry 2 Gewinkelt horizontal Horizontal, right-angled 3 Gewinkelt vertikal Vertical, right-angled	10 Schwarz Black 30 Weiß White	60 Sel. Au/Sn 80 Sel. Au 0,75µm/Sn (USB 2.0)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:

